

國立政治大學 函

機關地址：臺北市文山區指南路二段64號
聯絡人：劉玉玲
聯絡電話：02-29393091#66899

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 114年7月8日

發文字號：政研發字第1140022726號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：申請須知、國科會函

主旨：國科會與德國聯邦研究、科技及太空部(BMFTR)共同徵求2026-2029年「臺德半導體晶片設計學術合作研究計畫」校內截止收件時間為114年9月24日(星期三)下午5時止，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依國科會114年7月3日科會科字第1140047005號函辦理。
- 二、依據國科會及德國BMBF於2023年3月21日簽署臺德科學及技術合作協議(STA)，共同徵求旨揭計畫(第三期)，申請方式詳如附件公告申請須知及國科會網頁「計畫徵求專區」。
- 三、本項徵件計畫期程以3年為原則，自2026年7月1日開始執行，臺德雙方計畫主持人共同研議計畫內容後，須分別向國科會及德國BMBF於申請截止期限內提出申請書，始得成案。
- 四、為使更多半導體領域之學者專家參與本次共同徵件，國科會與德方BMBF將於2025年7月24日(星期四)下午，共同舉辦「臺德雙邊研究人員線上交流會議」，鏈結臺德半導體領域學者互動交流，歡迎有興趣學者線上參與，報名及參與方式另於國科會網站公告。
- 五、有意申請者請於旨揭截止期限前完成線上申請作業，並

請所屬單位於次日中午前將申請名冊（經單位主管核章）送達研發處，俾利備函彙送國科會提出申請。

六、檢送國科會來函及申請須知各1份。

七、本計畫相關申請疑義，請洽國科會科國處李蕙瑩研究員，電話：(02)2737-7150；有關係統操作問題，請洽國科會資訊系統服務專線，電話：0800-212-058及(02)2737-7590~7592。

正本：本校各院、系、所、研究中心(電子布告欄)

副本：研究發展處

校長 李蔡彥